

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日

配当金受領 期末配当金:3月31日
株主確定日 中間配当金:9月30日

単元株式数 100株

定時株主総会 毎年6月

公告方法 電子公告(<https://www.fujimiinc.co.jp>)
ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

〒100-8212
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〒137-8081
郵便物送付先 新東京郵便局私書箱第29号
及び照会先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711 (通話無料)

株式会社フジミンコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部経営企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL： <https://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2023 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等

証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。

証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

特別口座に記載された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問い合わせください。

特別口座管理機関 日本証券代行株式会社

〒168-8620
連絡先 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
日本証券代行株式会社 代理人部
電話 0120-707-843 (通話無料)



この印刷物は、適切に管理された森林で生産された木材を使った環境配慮型のFSC®認証紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ[ベジタブルインキ]を使用しております。

株式会社フジミンコーポレーテッド 株主通信

FUJIMI TODAY vol.56

2022.4.1 ~ 2023.3.31

2023年6月発行

特集

新中長期経営計画トップインタビュー

技術を磨き、心をつなぐ



証券コード 5384



お客様目線の実践

パウダー&サーフェスカンパニーへの進化

「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当事者意識とやり抜く力の確立

革新への挑戦

研磨体験の様子(石徹白地区文化祭 当社展示ブースにて)

技術を磨き、 心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとしたさまざまな産業で活かされています。フジミはお客様にあらゆる製品を磨いていただくことで、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

代表取締役社長

関 敬史



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年3月期の経営成績

当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルスの世界経済へ与える影響が収束しつつあるものの、国際情勢の悪化を背景にした資源・エネルギー価格の高騰による物価上昇は継続しました。また、欧米の連続的な大幅利上げに加えて、米国の銀行破綻、欧州の銀行経営不安など世界の金融市場が混乱したことで世界的な景気後退懸念が一層高まり、世界経済の不透明感は強まりました。

世界半導体市場は、PC、スマートフォン及びサーバー市場の低迷を受け、下期に半導体デバイスの生産及び在庫の調整が加速しました。一方で、シリコンウェハーは下期において小口径ウェハーの生産調整が強まったものの、概して高い稼働が続きました。

こうした状況下、当連結会計年度の業績は、売上高58,394百万円(前期比12.9%増)、営業利益13,243百万円(前期比9.8%増)、経常利益13,595百万円(前期比8.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益10,594百万円(前期比15.7%増)となり、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益はいずれも過去最高となりました。

新中長期経営計画策定

当社は2024年3月期から2029年3月期の6年間を対象とする「中長期経営計画2023」(以下、本計画)を新たに策定しました。詳細につきましては次ページ以降の「新中長期経営計画」でご説明いたしますが、本計画では研究開発とグローバルな製品供給体制の拡充に一層の経営資源を投入するとともに、サステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに係る取り組みを積極的に推し進めてまいります。

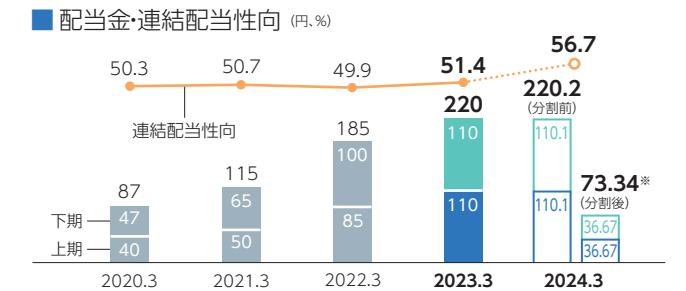
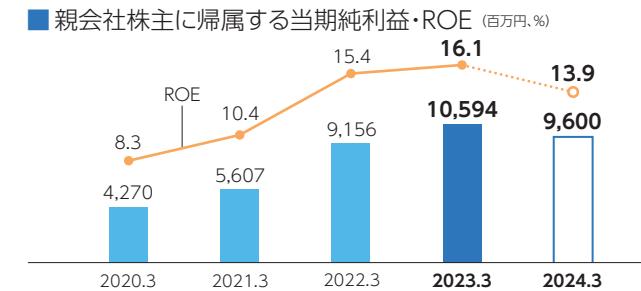
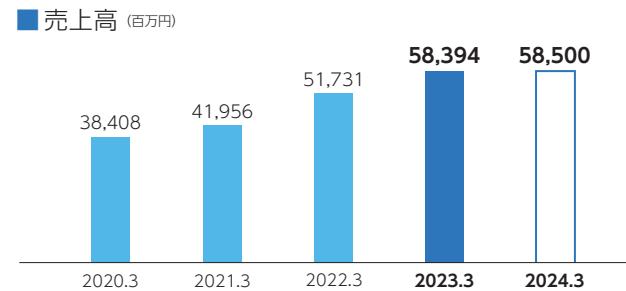
株式分割と配当方針の変更

株式の流動性を高めるとともに個人投資家の皆様へ投資していただきやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的に2023年6月30日を基準日として当社普通株式を1株につき3株の割合を持って分割することといたしました。

また、株主の皆様への還元を強化するべく目標とする連結配当性向をこれまでの50%以上から2024年3月期より55%以上まで高めることといたしました。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

連結決算ハイライト ※2024年3月期は予想値



※当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、2023年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割することを決議しており、2024年3月期(予想)の配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。

FUJIMI

新中長期経営計画トップインタビュー

当社は、2023年5月18日に「中長期経営計画2023」を発表しました。
今号では、本計画について社長の関にインタビューしました。



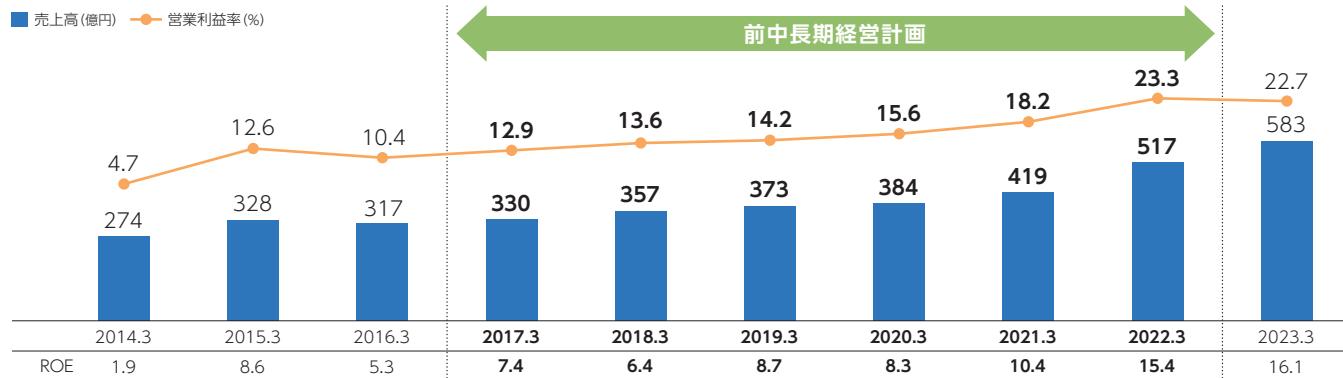
前回の中長期経営計画を振り返っていかがでしょうか？

目標を達成できた面と未達成の両面ありました。

前中長期経営計画(前計画)を発表した2016年11月時点では、当社が主に事業展開する半導体市場は、成長の鈍化がみられていました。そうした環境下で安定的かつ持続的な成長を遂げるために、特定の市場や用途に偏ることがない安定した事業構造の構築を目指しました。ところが、半導体市場は一時的にメモリ半導体のマイナス成長があったものの、年率10%を超える大

きな成長を遂げました。当社においてもシリコンウェハー向け製品及び最先端のロジック、メモリ半導体向けのCMP製品売上が大きく伸長したことから、営業利益率、ROEは目標を達成しました。

一方で、新規事業においては、筐体用途で素材の変更による研磨ニーズの縮小、その他新規開発分野においても開発品の採用に時間を要したことから売上は伸びず、新事業売上構成比及び連結売上高は目標に届きませんでした。



今回の新中長期経営計画の狙いは？

始めに、中長期企業ビジョンは、前計画と同じ「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」を引き続き掲げてまいります。これは、社員一人ひとりから自発的なアイデアとチャレンジが次々と生まれ、それを育む土壌を整えることで、環境の変化に対応し、企業文化ビジョンに掲げた「強く、やさしく、面白い」会社へ向かっていくことを意図したものです。

定量目標に関しては、世界経済の不透明感や米中間の緊張、環境問題への対応など、当社事業を取り巻く環境は非常に不透明な状況ではありますが、本計画期間中はデータセンターや

自動車、産業機械向けを中心に半導体市場の伸長が見込まれることから、計画最終年度(2029年3月期)の売上目標を950億円としました。その中で新規事業向けは2%から20%に、非半導体向けは14%から25%に、非研磨向けは4%から10%に売上の割合をそれぞれ引き上げてまいります。

営業利益率については、通常であれば売上増加に伴い固定費が分散し、収益性は向上しますが、本計画期間中に大規模な設備投資を行い減価償却費が増加することから20%に留まる見込みです。一方、事業の稼ぐ力、キャッシュ獲得能力を表すEBITDA^{*1}

新中長期経営計画(定量目標)

2030年に目指す姿 収益性確保を図りつつ、連結売上高1,000億円を目指す

目標項目	2023年3月期 (実績)	2024年3月期 (期初予想)	2026年3月期 (計画)	2029年3月期 (計画)
連結売上高	583億円	585億円	770億円	950億円
新規事業売上構成比	2.0%	3%	15%	20%
非半導体売上構成比	14.0%	15%	20%	25%
非研磨分野売上構成比	4.4%	5%	8%	10%
営業利益率	22.7%	21.4%	20%	20%
EBITDAマージン ^{*2}	25.6%	25.0%	26%	27%
ROE	16.1%	13.9%	15%	15%
配当性向	51.4%	56.7%	55%	55%

還元の変遷と新還元方針

- 株主還元を一段強化
 - 変更後 連結配当性向 55%以上を目標
 - 変更前 連結配当性向 50%以上を目標
- 安定配当の継続にも留意し、DOEを配当の指標に加えることも検討する

^{*1} EBITDA: 営業利益+減価償却費。事業の稼ぐ力(キャッシュフロー獲得能力)を表す。
^{*2} EBITDAマージン: 売上高に占めるEBITDAの割合。

の売上に対する割合、EBITDAマージンは現行の25%台から27%に上昇を見込みます。

自己資本に対する利益の割合、どれだけ効率的に利益を稼いでいるかの指標であるROEの目標は15%とします。

株主還元に関しては、2024年3月期より連結配当性向の目標を現行の50%以上から55%以上に引き上げました。

基本方針は、既存事業(半導体関連事業等)のさらなる拡大に加え、新たな柱となる新規事業の創出を通じて、前計画より取り組む「研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化」を遂げ、持続可能な社会の実現への貢献を目指すこととしました。

また、本計画では、研究開発とグローバルな製品供給体制の拡充に一層の経営資源を投入するとともに、サステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに係る取り組みを積極的に推し進めてまいります。

重要施策

- 1 研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化を実現する新規事業の創出
- 2 半導体関連事業の強靱な基盤構築と次世代半導体向け材料分野での圧倒的な地位確立
- 3 コア技術の発展と新技術の開発
- 4 100年企業を実現するGRIT[※]な組織と人づくりへの挑戦
- 5 サステナビリティ経営の実践

※GRIT: 困難な状態にも挫けることなく、目標に向かって最後までやり抜くこと。

設備投資と研究開発について

設備投資に関して、ここ数年は年間20億円程度で推移し、2018年3月期から2023年3月期の6年間の累計は112億円でしたが、本計画では6年間の累計で約550億円の投資を計画しております。具体的には、①新工場の建設(日本)、②既存工場の増強(日本・台湾)、③既存工場の隣に新棟建設(米国)、④新たな研究開発センターの建設(日本)を進め、生産設備の拡充と新規事業の研究開発と育成を推進してまいります。

研究開発費に関して、当社の売上の8割以上は半導体関連が占めていますので、お客様である半導体メーカーの技術ロード

マップに追従し、高度な要求に対応するためにも多額の研究開発費が必要になります。また、非半導体においても積極的に投資し、新規事業の創出を推進すべく、研究開発に投下する金額は年平均9%で増加していく見込みです。

半導体関連における成長戦略について

足下の世界半導体市場は、パソコンやスマートフォン、サーバーなどの需要低迷を受け、2022年秋から生産及び在庫調整が継続しており、米Gartner社によれば、2023年は前年比11.1%減(2023年4月公表)と2桁のマイナス成長が見込まれています。しかしながら長期的には、市場規模は足下の5,000億ドル台から、2030年には1兆ドルを超える規模に拡大すると予想されています。

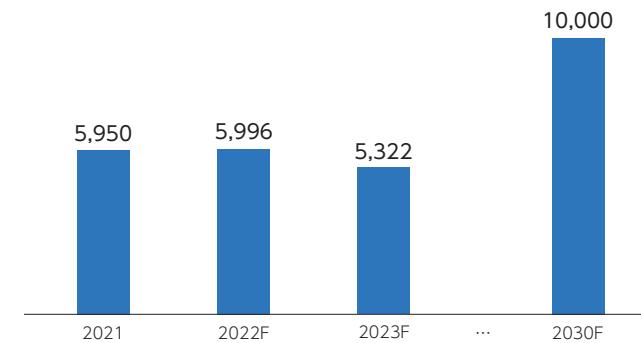
半導体はAI(人工知能)や自動運転など世界中が注目する最新技術に欠かせないものとなっており、その重要性と期待される市場の成長性から、世界各国が半導体の国産化を狙い、国家主導の投資によって半導体の確保及び生産シェアの拡大を図っています。

当社は、この市場拡大を見据え、グローバルな製品供給体制の拡充を推し進めるとともに、半導体プロセスの高度化に応える業界トップ水準の研究開発・品質保証力の維持と向上に取り組んでまいります。

また、2025年以降に本格化が見込まれる次世代実装技術を用いた基板に関しても、現在、お客様の要求に沿った研究開発や技術サポート活動を行っております。本技術を用いた基板が量産されるのはさらに数年先になると予想されますが、この分野での事業機会獲得を目指してまいります。

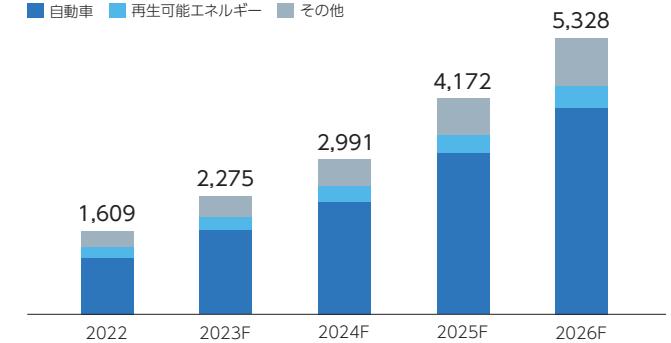
さらには、脱炭素社会の実現に向け電気自動車(EV)や再生可能エネルギーへの関心が高まる中で、SiC基板を用いたパワー半導体の市場が急成長しており、その市場規模は2035年には2022年の30倍以上となる5億ドルを超えるとの予測も出ています。当社では、日本と米国でSiC基板向け研磨材の開発を進めており、前期までに大手のお客様での採用を獲得し、米国とマレーシアの工場で量産を開始しております。コア技術を基盤とした新技術を確立し、高効率性を有する新製品投入によりマーケットシェアの拡大を目指してまいります。

世界半導体市場動向(年次 実績/予測) (億USD)



2021 ~ 2023F: 米Gartner社(2023年4月)発表を基に当社でグラフを作成
2030F: 各種資料を参考に当社でグラフを作成

SiCパワー半導体市場動向(年次 実績/予測) (百万USD)



SiCパワー半導体市場 出所:TrendForce(2023年3月)

非半導体関連における成長戦略について

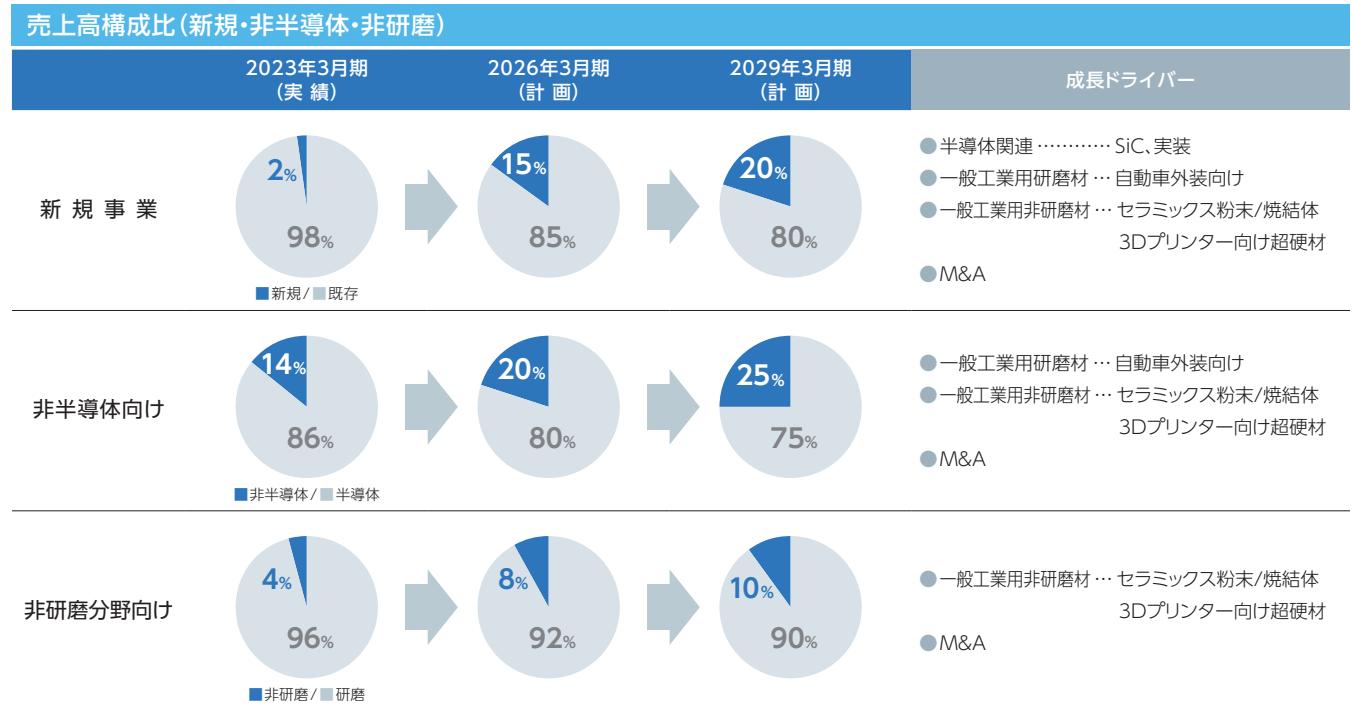
当社の半導体関連の売上は全体の86%、非半導体関連の売上は14%(2023年3月期)と、半導体関連への依存がかっていない程に大きくなっております。

当社としては、安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要と考え、前計画より非半導体関連の新規用途開拓や研究開発を推進しています。この方針は本計画においても変更はありません。

非半導体関連のパウダー(粉)分野では、高い放熱性と流動性を備えたセラミックパウダー、軽量かつ高い耐熱性を備えたセラミックス複合材料、板状の形状で高白色かつ粒子径と厚みが揃っ

ているリン酸チタン粒子や3Dプリンター用超硬材料などの特出した機能を持つ機能材料の研究開発を加速させ、事業化につなげていく考えです。サーフェス(表面)分野では、2022年2月に上市した自動車塗膜用の研磨材をはじめ、お客様のウォンツに応える研磨ソリューションの提供を推進してまいります。

また、未参入もしくは新規の有望案件の発掘と獲得に取り組むとともに、新規事業の創出及び成長に必要な技術取得に向けたM&Aも検討してまいります。



ESGへの取り組みについて

ESGへの取り組みに関しては、持続可能な社会の実現に向けて、当社が優先して取り組む重要課題として18のマテリアリティを特定しました。

マテリアリティの特定にあたっては、当社だけの考えにならないようステークホルダー(お客様や仕入先、地域など)にインタビューを行い、ステークホルダーが重要視すること、当社に期待することは何かを確認しました。その上で抽出した課題をE(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)と、当社の成長に資する価値創造を加えた4分類に分け、優先順位付けを行っております。

今般のマテリアリティの特定に伴い、当社が貢献すべき社会

課題への認識を深め、事業活動を通じて課題解決へ向けた取り組みを進めてまいります。今後は社会動向・自社の取り組み状況を踏まえて、定期的にマテリアリティを更新する予定です。

本計画を今後の持続的成長の礎とすべく、重要施策及び各種投資を計画的に推進し、創業80周年にあたる「2030年3月期に連結売上高1,000億円」を目指してまいります。株主の皆様には、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。





シリコン ウェハー用

売上構成比 **35.7%**

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。

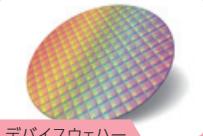
売上高 (百万円)

2022.3 **18,399**

13.2%
UP

2023.3 **20,824**

ラッピング材の売上高は7,094百万円(前期比13.5%増)、ポリシング材の売上高は13,730百万円(前期比13.0%増)となりましたが、小口径ウェハーの生産調整を受け、第3四半期以降の販売の伸び率(対前年同期)は鈍化しております。



CMP用

売上構成比 **49.1%**

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。

売上高 (百万円)

2022.3 **24,571**

16.7%
UP

2023.3 **28,680**

売上高は28,680百万円(前期比16.7%増)となりましたが、半導体市場の調整を受け、ロジック、メモリ向けともにアジアでの販売の減少が響き、第3四半期以降の販売の伸び率(対前年同期)は大きく鈍化しております。



ディスク用

売上構成比 **2.6%**

デジタルデータの記録媒体であるハードディスクドライブ用ディスク基板の製造工程に用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。

売上高 (百万円)

2022.3 **1,725**

12.7%
DOWN

2023.3 **1,506**

特に第3四半期におけるHDD(ハードディスクドライブ)市場の急激な生産及び在庫の調整を受け、売上高は1,506百万円(前期比12.7%減)となりました。



一般工業用・ その他

売上構成比 **12.6%**

多種多様な用途向けに研磨材や機能性材料を提供しております。また、半導体装置、航空機及び鉄鋼などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。

売上高 (百万円)

2022.3 **7,034**

5.0%
UP

2023.3 **7,383**

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、売上高は4,603百万円(前期比4.4%増)、その他につきましては、2,779百万円(前期比5.9%増)となりました。

株式分割のお知らせ

当社は2023年6月30日を基準日とし、同日最終の株主様を対象に2023年7月1日を効力発生日として、当社の普通株式を1株につき3株の割合をもって株式分割することをご案内いたします。

日程	基準日公告日…2023年6月15日(木)
	基準日……………2023年6月30日(金)
	効力発生日………2023年7月1日(土)

「JPXプライム150指数」構成銘柄に選定

当社は、株式会社JPX総研にて、「JPXプライム150指数」の構成銘柄として選定されました。同指数は「価値創造が推定される我が国を代表する企業で構成される指数」をコンセプトに新たに開発され、当社は財務実績に基づく「資本収益性(エクイティ・スプレッド基準)」により選定されました。

名証IRエキスポ2023出展のお知らせ

当社は、2023年9月8日(金)、9日(土)に名古屋吹上ホールで開催される名証IRエキスポ2023に出展します。本IRフェアへの出展は、当社コロナ対策により対面イベントへの出展を見合わせていたこともあり、2019年7月以来、4年ぶりの出展になります。

[名証IRエキスポ2023の詳細はこちら](#)

https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/

石徹白での活動紹介ビデオ3・4作目を制作

2023年3月・5月に石徹白での活動紹介ビデオ3作目・4作目を制作しました。ぜひ、ご覧ください。



[1・2作目はこちらからご覧いただけます。](#)

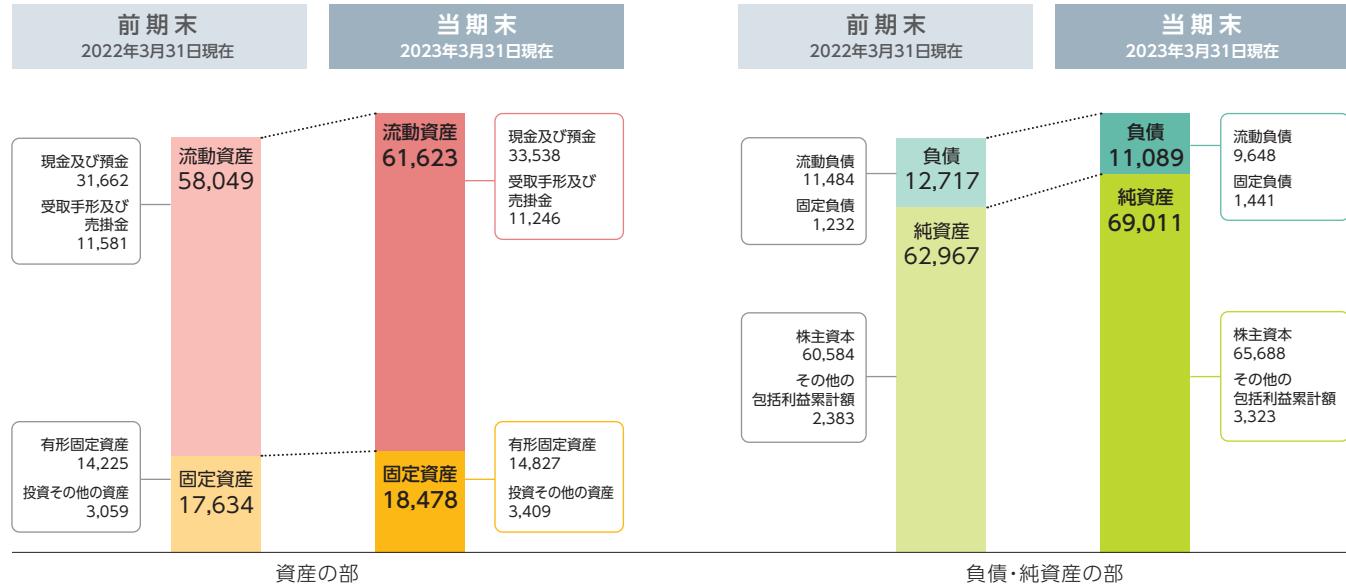
FUJIMI INCORPORATED 広報チャンネル
<https://www.youtube.com/@fujimiincorporated5384>

株主様アンケートについて

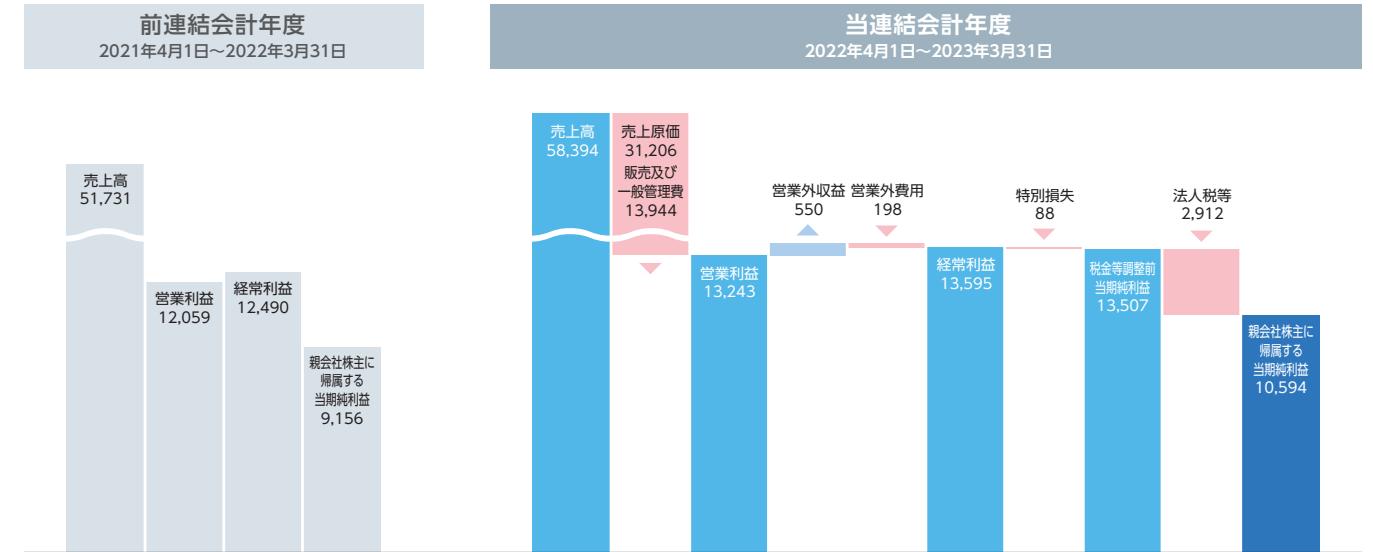
※アンケート:1単元(100株)以上所有の株主様を対象にお送りしております。

当社は株主様のご意見を伺う機会として株主様にアンケート*をお送りしております。前55号をお送りした際のはがきではアンケート方法に関するご意見をお伺いいたしました。アンケート方法をWEBに切り換えることに「賛成」47.9%、「反対(=はがき継続)」21.6%、「どちらでもない」30.5%の結果となりました。WEB切り換えに賛成のご意見が多い一方で、反対とのご回答や「賛成」と回答された方にも、自由記述にできればはがきを望むとの声も一定数ございますので、はがきを継続してまいります。

連結貸借対照表の概要 (百万円)



連結損益計算書の概要 (百万円)



解説

総資産

前連結会計年度末に比べ、4,416百万円増加し、80,101百万円となりました。これは、有価証券が2,200百万円減少したものの、原材料及び貯蔵品が2,614百万円、現金及び預金が1,876百万円、商品及び製品が1,251百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

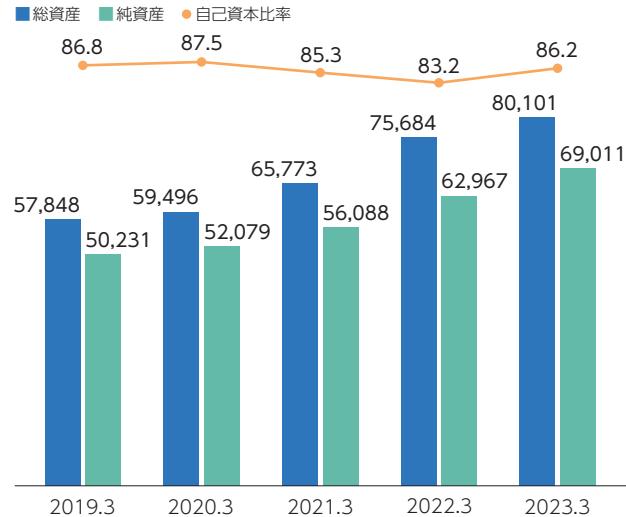
負債

前連結会計年度末に比べ、1,627百万円減少し、11,089百万円となりました。これは、未払法人税等が1,415百万円減少したこと等によるものです。

純資産

前連結会計年度末に比べ、6,044百万円増加し、69,011百万円となりました。これは、利益剰余金が4,604百万円増加したこと及び自己株式の残高が2,339百万円減少したこと等によるものです。

総資産・純資産・自己資本比率 (百万円、%)



解説

売上高

PC、スマートフォン及びサーバー市場の低迷を受け、半導体デバイスの生産及び在庫の調整は加速しました。一方で、シリコンウェハーは、小口径ウェハーの生産調整が強まったものの高い稼働が続いたことにより、売上高は前期比12.9%増の58,394百万円となりました。

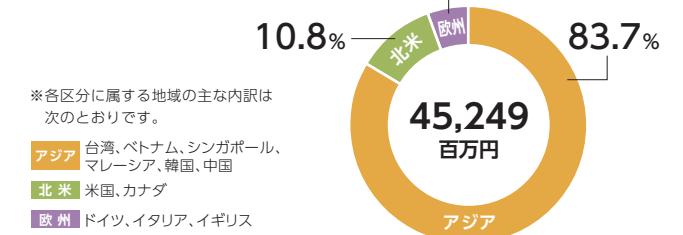
営業利益

前期比9.8%増の13,243百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益

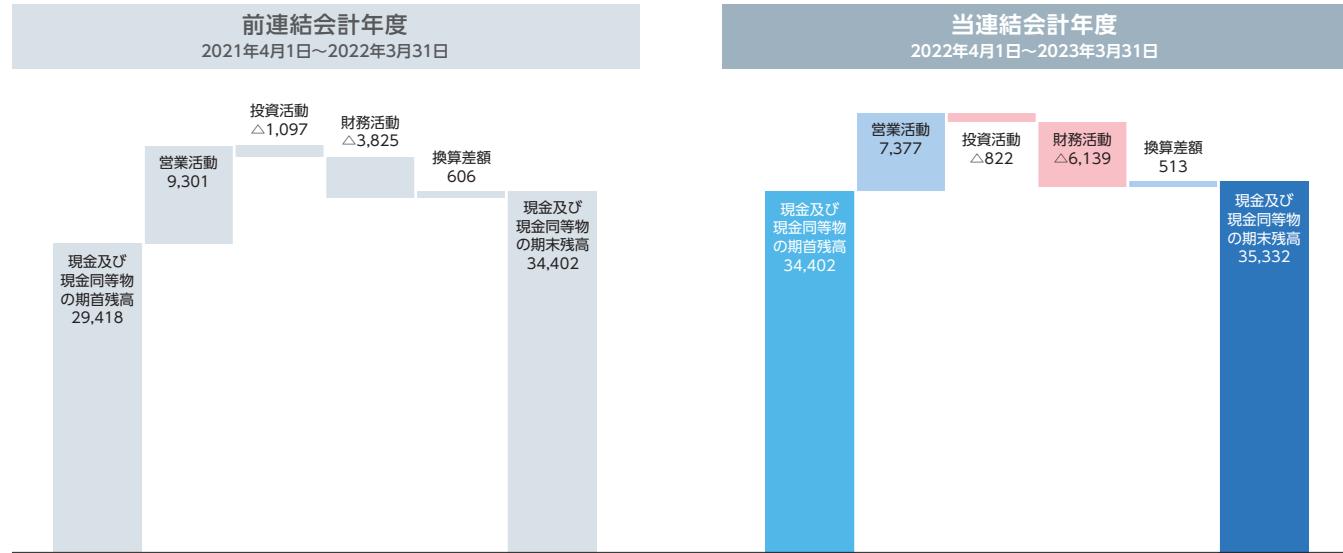
前期比15.7%増の10,594百万円となりました。

海外売上高 (仕向先別)

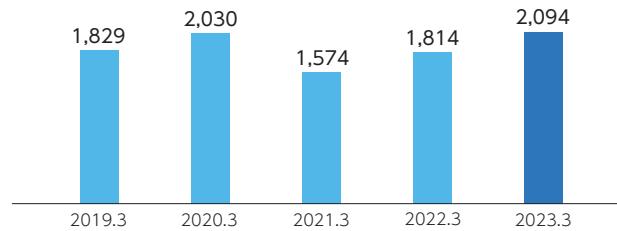


海外売上高	前期末 2022年3月31日	当期末 2023年3月31日
海外売上高 (百万円)	39,920	45,249
連結売上高 (百万円)	51,731	58,394
連結売上高に占める割合 (%)	77.2	77.5

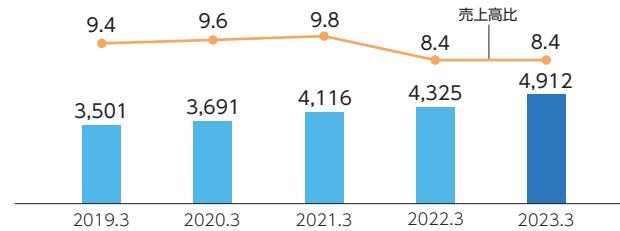
連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)



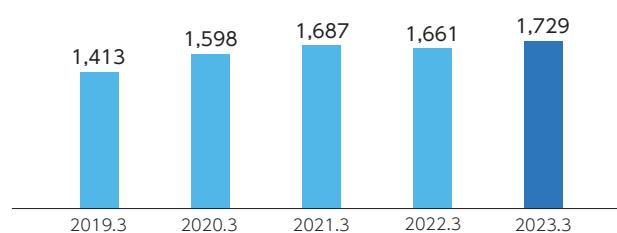
設備投資 (百万円)



研究開発費・売上高比 (百万円、%)



減価償却費 (百万円)



利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を50%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、当期末配当金につきましては、1株につき110円といたします。この結果、中間配当を含めた当期の配当金は1株につき220円となります。

株式情報 2023年3月31日現在

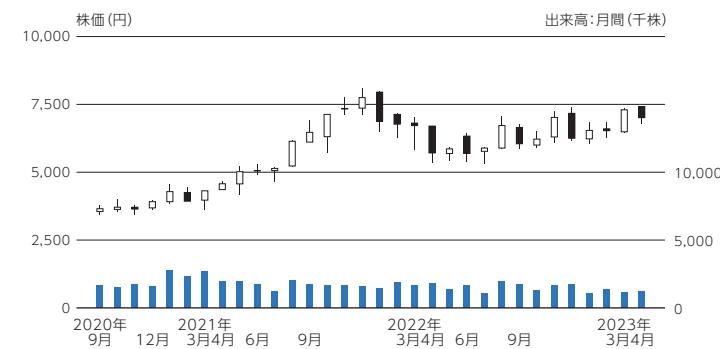
株式の状況

株式数	発行可能株式数	120,000千株
	発行済株式総数	26,699千株
	株主数	8,142名

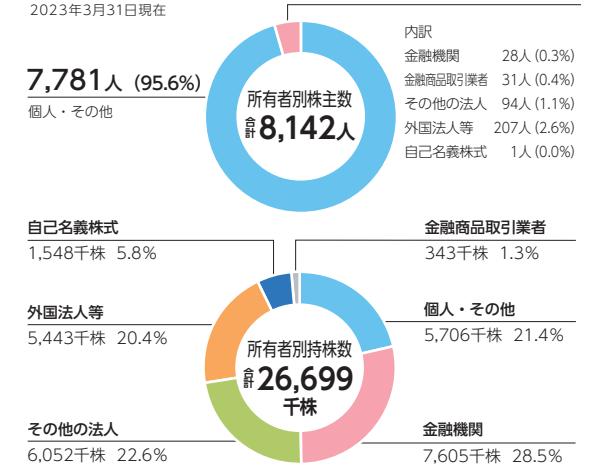
大株主(株主名)	持株数 (千株)*1	持株比率 (%)*2
有限会社コマ	4,460	17.7
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,732	10.8
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1,507	5.9
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,425	5.6
株式会社三菱UFJ銀行	728	2.8
フジミ取引先持株会	649	2.5
日本生命保険相互会社	639	2.5
一般財団法人越山科学技術振興財団	600	2.3
株式会社かんぽ生命保険	475	1.8
第一生命保険株式会社	472	1.8

*1 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。
*2 持株比率は、自己株式(1,548,464株)を控除して計算しております。

株価及び出来高の推移



株主分布状況 2023年3月31日現在



役員

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	大脇 寿樹
常務取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
取締役	浅井 侯序*
取締役	吉村 温子*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

*印は社外取締役 **印は社外監査役

会社データ 2023年3月31日現在

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	1,031名(単体732名)